



HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

hole penetrating from the first surface to the second surface; a protective resin part disposed in the through hole of the inorganic substrate and disposed so as to cover the side surface of the inorganic substrate; and a through electrode including a conductor part extending inside the through hole, the through electrode electrically connecting the first surface and the second surface.

(57) 要約: 本発明では、反り抑制が可能であり、高い信頼性を備えた多層配線基板および多層配線基板の製造方法の提供を目的とする。本発明の多層配線基板の一つは、第一面と、前記第一面に対向する第二面と、前記第一面の周縁部と前記第二面の周縁部とを接続する側面を有し、前記第一面から前記第二面まで貫通する少なくとも1つの貫通孔が形成された無機基板と、前記無機基板の前記貫通孔に配置され、かつ前記無機基板の前記側面を覆うように配置される保護樹脂部と、前記貫通孔内に延在する導電体部を含み、前記第一面と前記第二面の間を電氣的に接続する貫通電極と、を備えることを特徴とする。